

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-031

气派科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的自愿披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：气派芯竞科技有限公司
- 投资金额：公司出资 4,950.00 万元设立气派芯竞科技有限公司。
- 本次开展的业务为集成电路封装产业中的前端工序晶圆测试业务，为客户提供晶圆测试服务。
- 相关风险提示：
 1. 本次新设立公司的经营受宏观经济与行业政策变化、行业供需与市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，存在市场风险、经营风险等。
 2. 开展的业务对公司研发能力、工艺技术、资金实力、客户资源等方面有较高要求。气派芯竞科技有限公司以 1,650.00 万元的价格受让东莞市译芯半导体有限公司的晶圆测试设备及其配套测试程序等，东莞市译芯半导体有限公司同意由其运营团队协助完成本次受让设备的安装、调试，且在前期提供技术及生产运营支持，同时东莞市译芯半导体有限公司也将协助将其现有客户资源导入至气派芯竞科技有限公司。与公司原有成品测试业务与晶圆测试业务存在一定的共通性，公司具备一定的研发能力。
 3. 开展的业务能减少客户晶圆物流周转频次以及运输途中的风险，与客户合作的粘性进一步加强。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

为进一步提高公司综合竞争实力,完善公司在集成电路封装测试的产业布局,充分发挥自身已有的集成电路成品测试禀赋,拟开展集成电路产业封装中的前端工序晶圆测试业务,公司与自然人张巧珍女士合计出资 5,000.00 万元人民币设立气派芯竞科技有限公司(以下简称“气派芯竞”)。

2. 对外投资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《气派科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项尚未达到公司董事会审议标准,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组。

本次对外投资无需经过董事会和股东大会审议。

3. 本次对外投资事项不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。

二、合资方的基本情况

1. 张巧珍

女,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年4月至今担任绍兴金邦电子有限公司经理、执行董事、法定代表人。张巧珍女士与公司不存在关联关系,亦不存在被列为失信被执行人的情况。

三、投资标的基本情况

1. 名称:气派芯竞科技有限公司
2. 注册资本:5,000.00 万元人民币
3. 注册地址:广东省东莞市石排镇石排工业大道9号1号楼
4. 股东出资方式、出资额和出资比例如下:

股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
气派科技股份有限公司	货币	4,950.00	99%
张巧珍	货币	50.00	1%
合计		5,000.00	100%

5. 经营范围：软件开发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、开展业务情况

（一）业务基本情况

1. 业务介绍

公司本次拟开展的业务为晶圆测试业务，是集成电路产业的细分领域，为公司现有封装业务的前端工序，其目的是保证晶圆在封装前鉴别出合格的芯片，晶圆测试可分为可靠性测试、电性测试、操作系统测试、寿命测试等。

气派芯竞以 1,650.00 万元的价格受让东莞市译芯半导体有限公司（以下简称“译芯半导体”）的晶圆测试设备及其配套测试程序等，译芯半导体同意由其运营团队协助完成本次受让设备的安装、调试，且在前期提供技术及生产运营支持，同时译芯半导体也将协助将其现有客户资源导入至气派芯竞。

2. 业务行业情况

随着集成电路的产业的不断发展，芯片功能的应用越来越广，终端客户对集成电路的质量要求越来越高，集成电路封装成本也不断升高，晶圆测试的重要性越来越大。

近年来，随着消费电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升，以及国家支持政策的不断提出，中国集成电路行业发展快速。

伴随着以 5G、车联网和云计算为代表的新技术的推广，更多产品将会需要植入芯片、存储器等集成电路元件，因此集成电路产业将会迎来进一步发展。

2021 年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021 年中国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.30 亿元，同比增长 18.20%。其中，设计业销售额为 4,519.00 亿元，同比增长 19.60%；制造业销售额为 3,176.30 亿元，同比增长 24.10%；封装测试业销售额 2,763.00 亿元，同比增长 10.10%。

（二）开展业务的合理性及必要性分析

1. 打造封装测试一站式服务，提升公司核心竞争力

为进一步拓展公司业务领域，提升公司核心竞争能力，结合公司在集成电路成品测试的技术和经验积累，公司拟开展晶圆测试，将公司打造为集晶圆测试、封装、成品测试一体的半导体封装测试一站式服务的综合性封装测试企业，提升公司的核心竞争力。

2. 满足晶圆测试市场需求

近年来，随着集成电路产业向中国大陆转移的趋势不断加强，中国集成电路市场迎来快速增长。根据中国半导体协会统计，自 2011 年至 2021 年，我国集成电路市场销售规模从 1,572 亿元增长至 10,458 亿元。随着中国集成电路市场的快速发展，集成电路的设计、制造、封装和测试等各产业链环节市场需求亦将快速增长。

3. 强化公司测试平台，提升公司品牌影响力

晶圆测试和集成电路成品测试存在一些相辅相成的共通性，开展晶圆测试业务可强化公司的测试业务，促进公司测试能力提升，提升公司品牌影响力。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资事项是基于公司整体战略布局和业务拓展的需要，利用公司的已有的测试核心技术和研发能力的禀赋，满足更多客户的需求，提升公司综合实力和整体竞争力。

本次新设公司开展业务模式为受让晶圆测试设备及其配套测试程序等，译芯半导体前期将提供技术、生产运营支持，同时译芯半导体也将协助将其现有客户资源导入至气派芯竞，有利于控股子公司顺利开展业务。。

本次对外投资事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。本次投资设立的控股公司将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险分析

（一）本次新设立公司的经营受宏观经济与行业政策变化、行业供需与市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，存在市场风险、经营风险等。

（二）开展业务对公司研发能力、工艺技术、资金实力、客户资源等方面有较高要求。气派芯竞以 1,650.00 万元的价格受让东莞市译芯半导体有限公司（以下简称“译芯半导体”）的晶圆测试设备及其配套测试程序等，译芯半导体同意由其运营团队协助完成本次受让设备的安装、调试，且在前期提供技术及生产运营支持，同时译芯半导体也将协助将其现有客户资源导入至气派芯竞，有利于气派芯竞顺利拓展业务。与公司原有成品测试业务与晶圆测试业务存在一定的共通性，公司具备一定的研发能力。

（三）开展的业务能减少客户晶圆物流周转频次以及运输途中的风险，与客户合作的粘性进一步加强。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日